

JEITA鉛フリー化 活動成果報告会2009

■主催：電子情報技術産業協会 電子実装技術委員会／実装技術標準化専門委員会

■担当部署：知的基盤部（標準G）

■参加者数：大阪会場62名 東京会場147名

概要

当協会「電子実装技術委員会」の下部組織である「実装技術標準化専門委員会」では、7月7日に大阪（大阪大学 中之島センター）、また7月10日に東京（芝浦工業大学 豊洲キャンパス）で、「鉛フリー化活動成果報告会2009」を開催しました。同報告会は、EUのRoHS指令を契機にすすめてきた当協会の鉛フリーはんだ実装実用化、普及促進へ向けた課題解決活動を毎年報告するものです。

当日は、主催者を代表して長谷川英一常務理事（東京）、戸倉毅事務局長（大阪）の挨拶に始まり、来賓として、経済産業省・商務情報政策局 情報通信機器課の小竹幸浩課長補佐にもご出席いただき、ご挨拶を賜わ

りました。報告テーマは、以下の通りで、電子部品・電子機器メーカ、材料メーカ、実装メーカなどの関係者を中心に、約210名の方々にご参加いただきました。今回は、最終まとめ年度のウイスカ防止技術の開発或いは、鉛フリーはんだを用いたフロー付け機器の損傷抑制技術の評価試験方法標準化の取り組みなどの国家プロジェクトテーマを中心に、JEITAとして独自に取り組んでいる高温鉛フリーはんだの標準化活動或いは「ハロゲンフリーはんだ材料の定義化（JEITA ET-7304）」制定等についての活動状況の紹介があり、活発な質疑応答がありました。

プログラム

司会：副委員長 山本克己氏（JEITA実装技術標準化専門委員会）

○主催者代表挨拶

常務理事 長谷川英一氏（(社)電子情報技術産業協会）

○来賓挨拶

経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課 課長補佐 小竹幸浩氏

○「中小機構・戦略的基盤技術高度化支援事業『電子実装の信頼性向上のためのウイスカ防止技術の開発』の取り組みについて」

大阪大学 教授 菅沼克昭氏

○「JEITA—錫ウイスカ抑制技術開発プロジェクト—室温ウイスカ、腐食ウイスカ、合金添加の効果」

大阪大学 教授 菅沼克昭氏

○「結晶粒径が外圧ウイスカへ及ぼす効果」

大阪：横浜国大 准教授 于 強氏

東京：横浜国大 准教授 澁谷忠弘氏

プログラム

○「ウスカ発生に対する腐食の影響」

大阪：上島 稔 氏（千住金属工業）

東京：竹内義博 氏（タムラ化研）

○「内部応力型ウスカ部会の活動成果」

大阪：藤村一正 氏（石原薬品）

東京：中村真人 氏（日立製作所）

○「外部応力型ウスカ部会の活動成果」

大阪：気賀智也 氏（ソニー EMCS）

東京：池部克彦 氏（日本モレックス）

○「溶接部ウスカWG(アルミニウム電解コンデンサ)の活動成果」

大阪：中田卓美 氏（パナソニックエレクトロニックデバイス）

東京：林 彰一 氏（日本ケミコン）

○「『高温鉛入りはんだ代替金属材料WG』の活動」

芹沢弘二 氏（日立製作所）

○「高温鉛入りはんだ代替金属候補材料について」

上島 稔 氏（千住金属工業）

○「ET-7304『ハロゲンフリーはんだ材料の定義』制定について」

荒金秀幸 氏（ソニー）

○「低銀化鉛フリーはんだペースト材料の開発状況」

大阪：盛林俊之 氏（ニホンゲンマ）

東京：島村将人 氏（千住金属工業）

○「METIプロジェクト」

司会：大阪大学 竹本 正 氏

『鉛フリーはんだを用いたフローはんだ付け機器の損傷抑制技術の評価試験方法標準化』の取り組みについて

芹沢弘二 氏（日立製作所）

○材料・メカニズム分科会及び大学での取り組み

『鉛フリーはんだによるステンレス鋼損傷への微細組織の影響』

芝浦工業大学 准教授 苅谷義治 氏

○表面処理分科会及び大学・研究機関での取り組み

『ステンレス鋼表面処理皮膜の各種特性の評価方法』

北海道立工業試験場 片山直樹 氏

『表面処理ステンレス鋼の損傷評価方法の検討』

群馬大学 教授 莊司郁夫 氏

○寿命評価分科会の取り組み

『フロー槽損傷のシステマ的抑制と損傷の定量評価方法の開発』

大阪大学 准教授 西川 宏 氏



報告会会場風景（大阪会場）



活発な質疑応答の様子（東京会場）